



表面贴装型 CX2016GR (车载应用)

2.0×1.6mm



■特点

- 车载应用晶体谐振器
- 小型(2.0×1.6×0.715mm)
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊
- 耐用的全陶瓷封装可对应树脂模
- 热循环焊接强度：-40~+125°C、3000次

■用途

- ECU
- 车载摄像机
- 雷达

■型号表示方法

CX2016GR 20000 D0 G T V CC  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②频率
- ③负载容量
- ④频率容差(常温偏差)
- ⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性
- ⑦个别规格(产品目录以CC标示)

D0 8 pF G ±15×10<sup>-6</sup>

TV -40 ~ +150 °C ±150×10<sup>-6</sup>

包装方式(载带包装 3000/ 15000个/卷盘)

AEC-Q200 RoHS指令对应产品

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f <sub>nom</sub>	16000 / 20000	kHz	其他频率, 敬请咨询。
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f <sub>tol</sub>	±50	×10 <sup>-6</sup>	25°C ±3°C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T <sub>use</sub>	-40 ~ +150	°C	
储存温度范围	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +150	°C	
频率温度特性	f <sub>tem</sub>	±150	×10 <sup>-6</sup>	对于25°C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

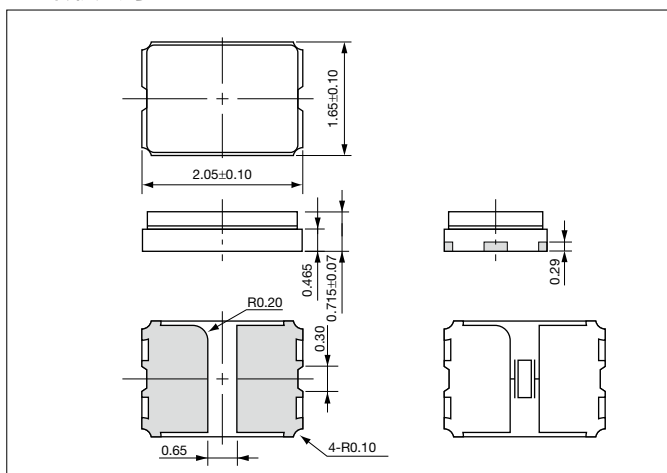
频率范围	串联电阻
16000kHz	300Ω max.
20000kHz	100Ω max.

■Table2 激励级

频率范围	激励级
16000, 20000kHz	10μW(200μW max.)

■外形尺寸

(单位 :mm)



■推荐焊盘图案

(单位 :mm)

